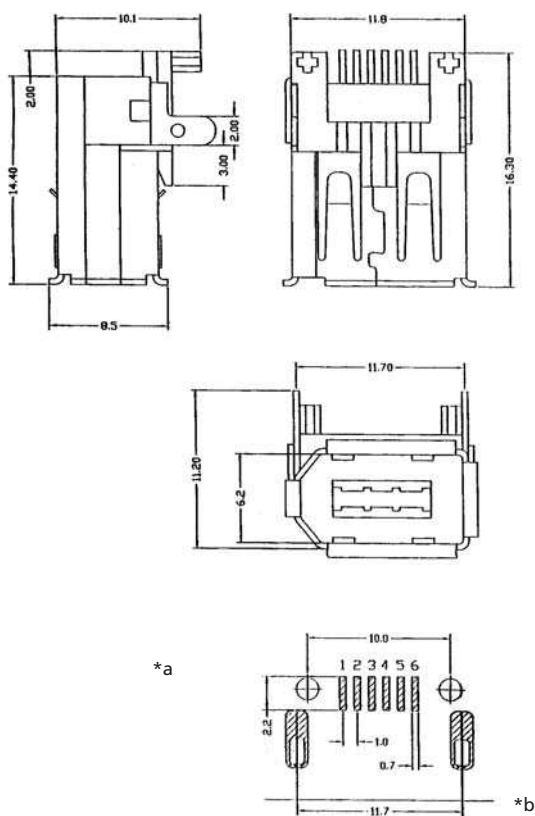



SMT


*a Leiterplattenlayout
 printed circuit board layout
 modèle de carte imprimée

*b Leiterplattenrand
 printed circuit board edge
 bord de carte imprimée

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
2417 02	6	100

Verpackung: im Tablett
 Packaging: in tray
 Emballage: en tableau

2417 02

IEEE-1394-Einbaukupplung, 6-polig, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

1. Werkstoffe

Kontaktträger	HTN GF
Kontakt	CuSn, selektiv vergoldet
Gehäuse	CuSn, verzinkt

2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit	IEEE-1394-Steckern 2311, 2316
-------------------	-------------------------------

3. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	≤ 1 A
Bemessungsspannung	30 V AC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

2417 02

IEEE 1394 socket, 6 poles, angular version, for printed circuit boards, surface mounting technology (SMT)

1. Materials

Insulating body	HTN GF
Contact	CuSn, selectively gilded
Shell	CuSn, tinned

2. Mechanical data

Mating with	IEEE 1394 plugs, 2311, 2316
-------------	-----------------------------

3. Electrical data

Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current	≤ 1 A
Rated voltage	30 V AC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

2417 02

Embase femelle IEEE 1394, 6 pôles, version angulaire, pour cartes imprimées, technologie des montages en surface (SMT)

1. Matériaux

Corps isolant	HTN GF
Contact	CuSn, doré sélectivement
Boîtier	CuSn, étamé

2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec	connecteurs mâles IEEE 1394 2311, 2316
-------------------	--

3. Caractéristiques électriques

Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné	≤ 1 A
Tension assignée	30 V AC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ